



H2111 环氧底部填充胶

H2111 是一款可重工的环氧产品，用于 CSP 和 BGA 的底部填充。在室温下保持低粘度，无需额外的预加热工序。该产品固化迅速，可减少对其它部件的应力。固化后，该材料具有高的玻璃化转变温度，在热循环和跌落测试中，可保持弹性以保护焊点连接。

产品描述

产品特性

条目	描述
技术类型	环氧
外观	黑色液体
组分	单组分
固化方式	热固化
应用	底部填充、密封
典型的产品应用	芯片级封装，BGA

产品优点

- 室温流动性好；
- 无卤；
- 可重工；
- 热循环可靠性好；
- 标准表面绝缘电阻 (SIR) 电性能稳定。

产品性能

未固化时性能

条目	典型值	备注
粘度 cps	354	GB/T 2794 20rpm
比重 g/ml	约 1.08	GB/T 13354
工作时间	3 天	@ 25° C, 25% 粘度上升



固化后性能

在推荐的条件下固化:

条 目			典型值	备注
物理性能	热膨胀系数 ppm/°C	Tg 以下	61	TM A
		Tg 以上	190	
	玻璃化转变温度(Tg) °C		124	TM A
	存储模量	2, 445 N/mm²		DMA, 三杆弯折, @ 25°C
354, 617 psi				
电气性能	表面绝缘电阻 Ω		1×10 ¹⁰	ASTM D257 (168 小时, 60°C/90% RH 测试后)

典型的固化性能

固化条件

条目	典型值	备注
热固化	60 分钟	@100°C
	30 分钟	@110°C
	10 分钟	@130°C
	7 分钟	@150°C

以上固化仅是推荐的指南。固化条件（时间和温度）应依据客户经验、应用要求、固化设备、烤箱负载、实际烤箱温度而不同。

注意事项

有关本产品的安全注意事项，请查阅安全数据资料。

标准包装

50ml/支

产品储存

将产品存贮于未开封的原装容器内，并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装标签。

本产品最佳存储条件：-20°C, 存储期 12 个月。



为防止未使用产品受到污染，请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息，请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注：本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果，我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外，及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题，包括针对某一特殊用途的适用性问题，我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。

湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路

中国长沙智能终端产业园 5 号栋

Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com